

工業局公私(產學)共育國內外高階人才計畫

112 年度技術審查入選提案課程

正取班級(36 班)			
領域	編號	開班單位	課程名稱
客製化 諮詢	1	人上人企管顧問股份有限公司	IC 封裝與測試製程參數之大數據蒐集與分析
	2	新矽國際顧問股份有限公司	ESD & Latch Up Design
	3	新矽國際顧問股份有限公司	高速訊號佈線準則與特性模擬分析
	4	新矽國際顧問股份有限公司	深度學習及應用
	5	三建資訊有限公司	【日本專家】 Solder Bumping Process
	6	三建資訊有限公司	【日本專家】半導體封裝材料的設計技術與評價方式
	7	三建資訊有限公司	【日本專家】高運算 HPC 先進半導體封裝技術
	8	三建資訊有限公司	【日本專家】5G 高速通訊用途之聚醯亞胺低介電損耗 (低介電率·低介電損耗角正切) 開發的分子設計與特性控制
	9	三建資訊有限公司	【日本專家】環氧樹脂的結構及硬化劑之選擇、變性、配方改質
	10	三建資訊有限公司	【日本專家】運用於量子運算模擬的自旋電子技術
	11	三建資訊有限公司	【日本專家】矽基量子比特位元及其可行性
加值 研習	12	新矽國際顧問股份有限公司	第三代半導體技術與產業趨勢
	13	新矽國際顧問股份有限公司	AI Transformer Network on Computer Vision and Image Processing
	14	三建資訊有限公司	【日本專家】 EUV 微影·光阻劑的最新技術動向與光阻微影成像的最先進技術
	15	三建資訊有限公司	【台日專家】整合異質功能材料的常溫、低溫接合技術動向與今後 3DIC 製程發展
	16	三建資訊有限公司	【日本專家】採 chiplet·矽橋 Silicon Bridge·3D Fan-Out 封裝的半導體元件之積體化製程和今後開發動向
	17	雷蒙德管理顧問有限公司	GaN 高頻及高功率元件應用
	18	雷蒙德管理顧問有限公司	GaN-on-Si 製程技術

工業局公私(產學)共育國內外高階人才計畫 112 年度技術審查入選提案課程

技術 研討	19	社團法人台灣平坦化應用技術協會	台灣晶圓平坦化論壇
	20	社團法人台灣電子設備協會	化合物半導體的挑戰與未來
	21	社團法人台灣電子設備協會	化合物半導體的實務應用
	22	三建資訊有限公司	【日本專家】使用 UV 固化樹脂的矽光子晶片(SiPh)和光纖連接元件技術
	23	三建資訊有限公司	【日本專家】CPO 封裝 (Co-Packaged Optics) 技術與今後動向
	24	三建資訊有限公司	【日本專家】製程微縮用 SOT-MRAM 高速記憶體
	25	三建資訊有限公司	【日本專家】次世代光互連的共同封裝技術，以及聚合物光回路技術現況與發展
	26	三建資訊有限公司	矽光子(Silicon photonics)之光積體電路研發趨勢
	27	三建資訊有限公司	【台愛專家】光子封裝技術研討會
	28	三建資訊有限公司	【日本專家】高運算 HPC 先進半導體封裝技術
	29	三建資訊有限公司	【日本專家】EUV 光刻、抗蝕劑材料最新動向、Beyond EUV 的未來展望
潛力 學程	30	國立台灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心	數位積體電路設計潛力學程
	31	國立台灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心	數位系統設計 (Digital System Design)
	32	財團法人光電科技工業協進會	化合物半導體工程師養成潛力學程
	33	國立高雄科技大學半導體工程系	半導體設備工程師實務技能培訓學程
	34	逢甲大學	半導體封裝測試實務潛力學程
	35	國立陽明交通大學	優質人才學程規劃_真藍芽耳機晶片與系統設計
	36	國立台北科技大學	半導體 AI 應用工程師潛力學程